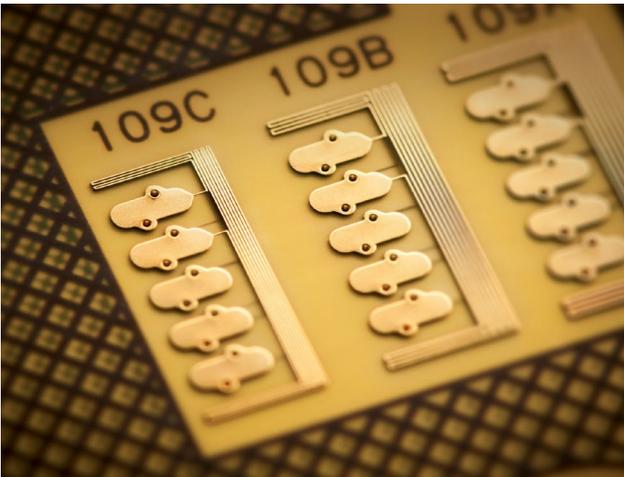


Leiterplatten (PCBs)

Flexible, starr-flexible und starre Leiterplatten

Cicor entwickelt und produziert seit über 50 Jahren anspruchsvolle flexible, starr-flexible und starre Leiterplatten von der Idee, über Prototypen bis hin zur Grossserienproduktion. Dank der umfassenden Fachkompetenz im Bereich der Multilayer-Boards (MLBs), Multi-Chip-Module (MCMs) und High-Density-Interconnects (HDIs) entwickelt Cicor innovative und zuverlässige Lösungen für anspruchsvolle Anwendungen in der Medizintechnik,

Industrie sowie Luft-/Raumfahrt und Verteidigung, Dünne Materialien sowie Leiter- und Abstandsweiten bis 25 μm ermöglichen eine weitere Miniaturisierung und fortschrittliche Ultra-HDI-Lösungen. Die DenciTec[®] Technologie eröffnet dafür vollkommen neue Möglichkeiten. Durch die Kombination von PCB-Verfahren und der Dünnschichttechnologie lassen sich innovative Schaltungen herstellen.



Portfolio

Flexible Leiterplatten

- Ultra High Density Interconnect
- Flex-Schaltungen (1 bis 8 Lagen)
- Polyimidfolien mit einer Dicke von nur 12.5 µm
- Klebebinden ab einer Dicke von 15 µm
- Gestapelte Vias und Via-in-Pad-Strukturen, die durch kupfergefüllte Blind Vias ermöglicht werden
- Hochpräzises Laserkonturschneiden

Starr-flexible Leiterplatten

- High-End-/Qualitätsbasismaterialien wie High-Tg/Low-CTE FR4 in Kombination mit Polyimidfolien
- Ersatz von starren Leiterplatten, Verbindungsteilen, Kabeln oder separaten flexiblen Leiterplatten durch die Integration der Verbindung verschiedener Teile in eine einzige starr-flexible Leiterplatte

- Reduzierung der Bauteilgrösse und Möglichkeit einer dreidimensionalen Montage bestückter Leiterplatten
- Verbesserte Signalintegrität und Zuverlässigkeit, insbesondere in Umgebungen, in denen Vibrationen, Beschleunigungen und andere schwere Bedingungen auftreten
- Reduzierter Logistikaufwand durch Ersatz mehrerer Komponenten durch eine einzige Leiterplatte

Starre Leiterplatten

- Starre Leiterplatten mit 1 bis 20 Lagen mit klarem Fokus auf die Miniaturisierung in der x-, y- und z-Achse
- (Ultra-) dünne High-End-Basismaterialien mit Ausdehnungskoeffizientwerten von weniger als 8 ppmK-1 in der x- und y-Achse

DenciTec®

- Leiterzugsbreiten und -abstände bis zu 25 µm
- Kupferdicken von 20 ± 5 µm auf allen Lagen
- Laser-Via-Durchmesser von 30 µm
- Restringe mit von 30 µm auf den Innenlagen und 20 µm auf den Aussenlagen
- Kupfergefüllte Blind-Vias mit der Möglichkeit zum Via-Stacking und Vias in Pads
- Ultradünne Schaltkreise durch Einsatz eines 12.5 µm Polyimid-Kernmaterials (4-Schicht-Flex-Schaltkreise mit weniger als 120 µm Dicke)

Märkte



Medizintechnik



Industrie



Luft-/Raumfahrt
und Verteidigung



Wearables



Gebäudetechnik

Kontakt



info-pcb@cicor.com



cicor.com/pcb

Produktionsstandort

Leiterplatten



Boudry, Schweiz

Die Cicor Gruppe ist ein weltweit tätiger Anbieter elektronischer Gesamtlösungen, von der Forschung und Entwicklung über die Produktion bis hin zum Supply Chain Management. Mit rund 2'650 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an 16 Standorten weltweit bedient Cicor führende Unternehmen aus den Bereichen Medizin, Industrie sowie Luft- und Raumfahrt & Verteidigung. Durch die Kombination von kundenspezifischen Entwicklungslösungen, Hightech-Komponenten und der Herstellung von elektronischen Geräten schafft Cicor einen Mehrwert für ihre Kunden.

cicor.com

